

# ユーロ円CB発行に関する補足説明資料

**RESONAC**

株式会社レゾナック・ホールディングス

2024年4月23日

項目	2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
発行会社	株式会社レゾナック・ホールディングス
発行形態	ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債
募集市場	欧州及びアジアを中心とする海外市場（米国を除く）
準拠法	英国法
年限	4年7ヵ月
発行金額	1,000億円
発行決議日	2024年4月23日（火）
条件決定日	2024年4月23日（火）～2024年4月24日（水）午前8時（日本時間）までの間のいずれかの時間
払込期日	2024年5月13日（月）
償還期日	2028年12月29日（金）
募集価格	102.5%
発行価額／償還価額	100.0%／100.0%
当初転換価額	未定
クーポン	0%
付帯条項	転換制限条項（130%、満期3ヶ月前まで）
ロックアップ	当社／引受契約締結日から払込期日後180日を経過するまでの期間
手取金の用途	半導体材料及びSiCエピタキシャルウェハーのための設備投資資金（約400億円）／ 長期借入金の返済資金（約600億円）
ブックランナー	Nomura International plc / Mizuho International plc

## CB発行に至る背景

### ▶事業ポートフォリオ改革

- 日立化成買収後はアルミ缶事業や診断薬事業など計9つの事業を売却
- 成長が期待される半導体・電子材料事業に経営資源を集中することを企図して、石油化学事業のパーシャル・スピノフについて検討を開始

### ▶半導体・電子材料事業への経営資源集中

- 後工程分野で世界トップクラスの売り上げ規模を誇る中、米国・シリコンバレーに新たな拠点を設け、さらなる開発を推進
- SiCエピタキシャルウェハー外販市場でトップクラスのシェアを誇る当社は、2027年までに売上高を2022年比で5倍に伸ばすことを目指す

### 2025年度目標

売上高 1兆円超	EBITDAマージン 20%
-------------	-------------------

## CBを選択した理由・目的

- 半導体材料分野における成長投資を加速させるとともに、積極的な戦略投資を可能とする財務基盤の強化を企図
- ゼロ・クーポンで発行されるため、金利コストの発生を回避でき、資金調達コストの最小化が可能
- 時価を上回る転換価額の設定に加え、転換制限条項を付与することで、当面の1株当たり利益の希薄化を極力抑制し、既存株主に配慮した設計が可能

## 調達資金（約1,000億円）

### 約400億円：半導体・電子材料事業における設備投資

- 半導体材料（CMPスラリー、銅張積層板、ダイボンディング材料等）及びSiCエピタキシャルウェハーのための設備投資資金（2025年12月まで）

### 約600億円：借入金の返済

- 長期借入金の返済資金に充当（2025年12月まで）
  - 積極的な戦略投資を可能とする財務基盤の強化を企図

### <半導体・電子材料事業への投資>

高い市場成長が見込まれる事業の生産能力拡大を企図したリソース配分

### 半導体材料

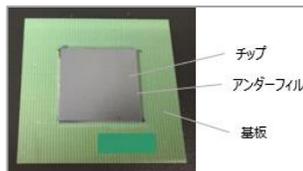
#### CMPスラリー

- CMP（Chemical Mechanical Planarization）に使用される研磨用スラリー
- 優れた研磨速度と平坦性、傷特性などがあり、半導体デバイスの微細な配線形成や高集積化に欠かせない材料



#### 銅張積層板

- 銅箔とガラスクロスと樹脂を貼り合わせて製造されるプリント配線板材料
- 5Gなど高速大容量通信に使われる回路基板に使用



#### ダイボンディング材料

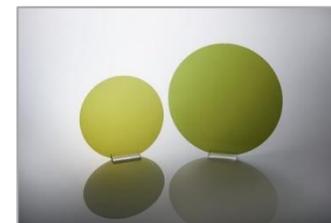
- 半導体のパッケージング工程（後工程）で使用する接着フィルム
- メモリ半導体の生産に際して、半導体チップを積層する際に使用



### 電子デバイス用部材

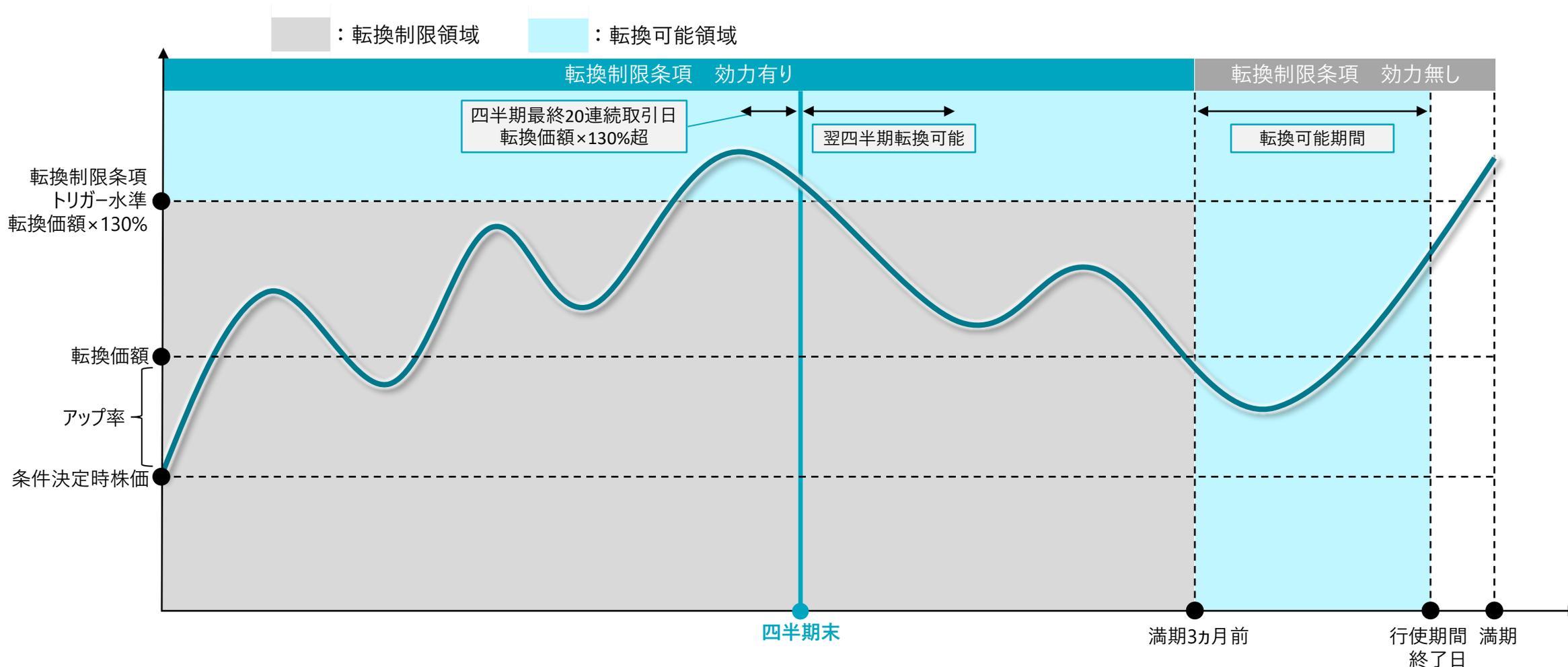
#### SiCエピタキシャルウェハー

- 省エネルギー化が期待される次世代のパワー半導体に使用される材料
- データセンターのサーバー電源や鉄道車両向けデバイス等に使用
- SiCパワー半導体は、優れた高電圧特性や大電流特性により、従来のシリコン半導体を凌駕する小型・低損失の半導体デバイスの実現が可能



## 転換制限条項

転換制限条項の付与により、期中の株価が転換価額の130%（～満期3か月前）を一定期間超えて推移しない限り、CB投資家が転換請求することのできない、負債性の高いスキームを採用



※上記株価変動は説明用のイメージであり、当社の株価の動きを予測又は保証するものではありません。

## Purpose

## 存在意義

### 化学の力で社会を変える

先端材料パートナーとして時代が求める機能を創出し、  
グローバル社会の持続可能な発展に貢献する

## Values

## 私たちが大切にしている価値観

- ▶ プロフェッショナルとしての成果へのこだわり
- ▶ 機敏さと柔軟性
- ▶ 枠を超えるオープンマインド
- ▶ 未来への先見性と高い倫理観

## Vision

## 目指す姿

### 日本発の「世界トップクラスの機能性化学メーカー」

世界で戦える会社	持続可能な グローバル社会に 貢献する会社	国内の製造業を 代表する 共創型人材創出企業
ワールドクラスの 事業競争力と収益力	イノベーション力と 事業開発力	共通の価値観を持つ 競争力のある人材の 育成力

## レゾナックの長期ビジョン 2030年に目指す姿

2030

Our Vision

- ▶ 世界で戦える会社
- ▶ 持続可能なグローバル社会に貢献する会社
- ▶ 国内の製造業を代表する共創型人材創出企業

### Action 2

- ▶ 半導体事業への経営資源集中
  - AI進展を通じ半導体材料業界の変革をリード



データセンター



自動運転



IoT & 生成AI

### Action 1

- ▶ ポートフォリオ改革
- ▶ CXO体制確立

▶ カルチャーの革新&人材開発

本資料は、2024年4月23日に株式会社レゾナック・ホールディングス（以下「当社」といいます。）が公表したプレスリリース「2028年満期ユー・ロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行に関するお知らせ」の補足説明資料として作成されたものであり、国内外を問わず当社の発行する株式その他の有価証券への勧誘を構成するものではありません。

本資料に記載される当社グループの目標、計画、見積もり、予測、予想その他の将来情報については、本資料の作成時点における当社グループの判断又は考えにすぎず、実際の当社グループの経営成績、財政状態その他の結果は、国内外の経済情勢、業界の動向、他社との競業、人材の確保、技術革新、その他経営環境等により、本資料記載の内容又はそこから推測される内容と大きく異なる可能性があります。本資料に記載される業界、市場動向又は経済情勢等に関する情報は、現時点で入手可能な情報に基づいて作成しているものであり、当社グループがその真実性、正確性、合理性及び網羅性について保証するものではありません。

本資料には、業界、市場動向又は経済情勢等に関し、当社グループの見立て、予想、又は試算に基づく情報が記載されていることがありますが、これらは、本資料の作成時点における当社グループの判断又は考えにすぎず、実際の結果はこれらと大きく異なる可能性があります。また、本資料に記載される当社グループにおける潜在的な収益機会に関する情報は、一定の仮定に基づき当社が現時点において想定する将来的な収益機会に関する潜在的な可能性（規模感）を示すものに過ぎず、特定の時点における当社の業績についての予想、計画、見込、目標等を示すものではなく、また、実際の結果はこれらと大きく異なる可能性があります。今後の状況の変更等が本資料の内容に影響を与える可能性があります。当社は、本資料を更新、修正又は確認する義務を負うものではありません。本資料の内容は事前の通知なく変更されることがあります。

本資料は、当社の転換社債型新株予約権付社債の発行に際して一般に公表するための資料であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。また、本資料は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の募集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成され、発行会社から入手可能な、発行会社及びその経営陣に関する詳細な情報及び財務諸表を含む英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における同社債の募集又は販売は行われず、同社債の登録も行われません。